

壹、致股東報告書

於民國 107 年股東常會

各位股東女士、先生，大家好：

2018 年我們雖然遭遇到中美貿易戰的開打、零組件的短缺、供應商的拉抬價格及智慧手機成長停滯等影響，但在客戶的全力支持及全體同仁的努力下，我們仍交出不錯的成績單。

展望 2019 年，這將是非常艱辛及挑戰的一年，雖然中美貿易戰可能達成初步的結果，但智慧手機及手持式應用產品的成長停滯及大家所盼望的下波主流產品如物聯網、5G 通訊、智慧駕駛、人工智慧、高速運算等產品要真正成熟需等到 2020 年或以後。

為了促使力成能在此急遽變化的競爭環境下得以永續經營，我設定兩個公司未來的營運重點：

1、傳承-公司接班團隊的安排：積極的發掘及培養人才，授予其更大的責任及權限，希望力成未來營運的領導中心能由新一代的經營團隊順利扛起。

2、贏的策略-我們在研發及業務的領域上持續強調

A. 技術 Technology

B. 品質 Quality

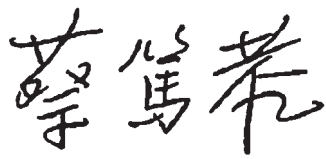
C. 服務 Services

力成過去二十年的持續發展，不僅取得股東及客戶的全力支持，也受益於半導體產業科技的不斷創新發展並擴大記憶體產品的需求，我們有幸能夠跟上時代的變化，剛好站在時代前進的浪頭上。我們要將環境給予我們的壓力轉變成技術創新的能力、業務及管理上改進的動力。

力成竹科三廠的興建是我們投資最先進技術的承諾，也關係著我們公司未來的成長及永續經營，只有持續不斷的創新、改革追求進步，才能使公司維持競爭力。期望各位股東能繼續給予我們支持，力成全體員工將能更團結努力並持續創造佳績。

再次感謝各位股東女士、先生的支持與愛護！

祝 大家身體健康，萬事如意

董事長： 
蔡篤恭

力成科技股份有限公司

一〇七年度營業報告書



一、107 年度營業報告書

107 年全球經濟在前 3 季仍維持 106 年的成長態勢，根據國際貨幣基金組織 (International Monetary Fund) 108 年 1 月「世界經濟展望」報告指出，107 年全球經濟成長率為 3.7%，與 106 年持平，主要原因來自於美國經濟強勁及原物料價格上漲，整體來看，主要國家經濟表現不一，美國持續擴張，歐洲復甦力道趨緩，日本經濟則受到天災及消費者和企業支出疲弱而出現萎縮。在中國大陸方面，外貿數據雖因關稅開徵搶購潮尚未產生明顯影響，但外需對經濟成長貢獻度仍有所下降，加上實體經濟受到內部融資環境趨緊影響，107 年中國大陸前三季經濟成長率分別為 6.8%、6.7%與 6.5%，不僅逐季下滑，亦創下金融海嘯以來最差表現。

在全球半導體的表現方面，根據國際研究暨顧問機構 Gartner 調查結果顯示，107 年全球半導體營收總計 4,767 億美元，較 106 年增加 13.4%。其中，記憶體占半導體總營收 34.8%，高於 106 年的 31%，並持續位居半導體各類別之首。不過，記憶體市場在 107 年下半年逐漸進入衰退期，加上美中貿易戰等變數增多，預期 108 年市場將會跟前兩年大不相同。在臺灣半導體產業表現方面，工研院產科國際所於 108 年 2 月統計 107 年台灣 IC 產業產值達新台幣 26,199 億元(868 億美元)，較 106 年成長 6.4%，其中 IC 封裝業為新台幣 3,445 億元，較 106 年成長 3.5%，IC 測試業為新台幣 1,485 億元，較 106 年成長 3.1%，整體表現不若全球半導體產業。

本公司受惠高效能運算應用與大量資料存儲記憶體的需求，在主要客戶所處產業榮景的帶動下，表現優於全球及台灣半導體產業，107 年全年度營收及獲利表現仍延續過去幾年出現顯著的成長，並達成我們的預期目標。未來我們仍將持續深耕技術、提供優良品質與服務、擴充產能以滿足客戶需求等方式來獲取客戶的信賴，透過集團資源整合等方式提高經營效率、降低成本並積極研發新技術、開發新產品線、投資新設備以及強化策略聯盟夥伴等方式，來增加本公司的競爭力。

茲將 107 年度的營運成果報告如下：

(一)107 年度營業實施情形

本公司 107 年度合併營收為 680 億 3 仟 9 佰萬元，較 106 年度的 596 億 3 仟 2 佰萬元成長了 14.1%；在盈餘方面，107 年度合併稅後純益歸屬於母公司股東的金額為新台幣 62 億 3 仟 4 佰萬元，較 106 年度淨利新台幣 58 億 4 仟 9 佰萬元成長了 6.58%。

(二)財務收支情形

107 年度合併現金流量狀況：

a.營業活動之現金淨流入	20,207,098 仟元
b.投資活動之現金淨流出	16,191,623 仟元
主要係取得不動產、廠房及設備	
c.籌資活動之現金淨流出	3,383,088 仟元
主要係配發股東現金股利及舉借銀行借款	

(三)獲利能力分析

分析項目		年度	107 年度	106 年度
獲利能力	營業利益 / 實收資本比率		125.57%	116.46%
	稅前純益 / 實收資本比率		121.10%	114.06%
	資產報酬率		7.67%	8.34%
	股東權益報酬率		14.62%	15.51%
	純益率		9.16%	9.81%
	每股純益		8.02 元	7.51 元

(四)研究發展狀況

本公司自成立以來即持續不斷的研發新技術及新製程以因應產業的發展及客戶的需求，除了持續致力於 DRAM 及 NAND Flash 記憶體產品的研發外，亦積極擴大邏輯 IC 及先進封裝產品與技術，在 Lead-Free Bump、Copper Pillar Bump、Flip Chip、low cost molded substrate FCCSP、SiP、WLCSP、RDL 及 Advanced Packages & Test technology 上建立了良好的技術，提供了我們開發高端邏輯產品客戶的基礎。107 年度研究發展費用約為新台幣 18.64 億元，約占全年合併營收的 2.74%。未來仍將持續積極投資在 TMV PoP、CIS CSP (TSV)、3D IC (TSV)、Panel Level Fan-Out 及尖端先進封裝測試技術的研究發展及製造，戮力成為物聯網(IoT)、mobile devices、automotive、networking、HPC、AI 及 VR/AR 相關產品封測服務的主要提供者。

二、108 年度營業計劃概要

(一)經營方針

1. 重承諾(Promise)、創新技術(Technology)、提供整合(Integration)服務為公司的核心價值。
2. 專注於半導體專業封裝及測試領域，與客戶、協力廠商共創利潤。
3. 致力於先進技術的研發、適時的導入新產品，提高企業成長動能。
4. 以穩定的品質、精湛的技术提供客戶全方位的服務。
5. 整合資源、強化經營績效，確保企業的獲利與永續經營。
6. 培育人才、重視員工福利與股東權益，創造共享價值。

(二)預期銷售數量

根據 WSTS (The World Semiconductor Trade Statistics) 在 107 年 11 月預估，108 年全球半導體市場銷售值將達 4,901 億美元，與 107 年相比，成長 2.6%；工研院產科國際所則預估 108 年台灣半導體產業產值將成長 5%。Gartner 預測，前三大高成長率應用市場分別為，工業/醫療電子、資料儲存電子以及汽車電子；就元件分類而言，以光電元件與感測器元件成長率較大。

WSTS 預估 107 年全球半導體市場總銷售值達 4,779 億美元，較 106 年成長 15.9%；與 106 年相同，主要由 Memory 市場 (1,693.5 億美元) 成長 33 % 所貢獻。依據 Gartner 預估，DRAM 市場因平均單價 (ASP) 上漲與應用增加因素，DRAM 市場成長 47.9%，NAND Flash 市場也成長了 7.2%；Memory 市場產值以應用別區分，是以通訊應用(智慧手機)、數據處理為主；另外若不含 Memory，其餘半導體市場僅有 6.1% 的個位數成長。

預期 108 年需求狀況，半導體最大應用的智慧手機出貨與電腦出貨量，已逐年趨緩甚至衰退，108 年全球手機出貨部分之出貨量預估將成長 5.3%；PC 部份，出貨量預估將小幅成長 1.4%；WSTS 預估，108 年光電元件、感測器、分立元件、類比 IC、邏輯 IC、微元件銷售額預估將會分別年增 6.8%、5.1%、3.9%、3.8%、3.8% 與 3.0%，而記憶體將出現成長率下滑的狀況，銷售額將會微幅下滑 0.3%。AI 智慧系統與 IoT 物聯網科技時代來臨，將引領數據處理應用比重高度成長，工業用與車輛用的半導體未來也因之持續向上成長。中國是半導體最大市場，積極在地化發展為半導體工廠，109 年之前中國的半導體在地化產值就會超過 2 仟億人民幣，唯美中貿易狀況需密切注意；而被視為下一個成長引擎的印度和東協等國家，雖然人口眾多，人均所得有所成長但仍偏低，加上相關通訊硬體建設不足，削弱行動裝置需求的成長速度。

本公司在 DRAM、NAND Flash、Logic 及先進產品元件將呈現微幅衰退。

訂定 108 年預期銷售數量如下：

銷售項目	預計銷售數量
封裝	約 110 億顆
測試	約 70 億顆
凸塊(Bumping)	約 80 萬片
晶圓測試	約 360 萬片
固態硬碟(SSD) + 薄型固態硬碟系統整合封裝(SIP)	約 8,000 萬個

(三)重要產銷政策

- 1.提供一元化(Turn-key)及直接出貨(Drop-shipment)的客戶服務以縮短交期及降低運送成本。
- 2.提升標準型 DRAM、Mobile DRAM、NAND Flash、UFS、Logic 等產品的比重。
- 3.持續 Logic 業務之拓展，並積極加速 Flip-Chip、SSD、Wafer level Packaging、晶圓級測試(CP)以及 Panel Level Fan-Out 的開發成長。
- 4.除了維持與現有客戶之長期合作關係，並積極拓展新市場、新應用、新客源及新產品的開發。
- 5.持續致力於成本控制，充分利用並整合集團資源，以提升公司競爭優勢。

董事長：



經理人：



會計主管：

